

REC'D

11 MAR 2005

101527437
PCT/JP2004/004163

13.5.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月28日

REC'D 08 JUL 2004

WIPO

PCT

出願番号
Application Number: 特願2003-089560
[ST. 10/C]: [JP2003-089560]

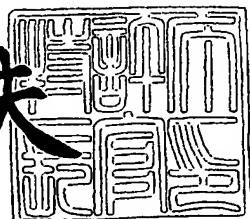
出願人
Applicant(s): 日本特殊陶業株式会社

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 6月17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 103-0534
【提出日】 平成15年 3月28日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G01K 7/22
【発明者】
【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内
【氏名】 半沢 剛
【発明者】
【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内
【氏名】 西 雅彦
【発明者】
【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内
【氏名】 岩谷 雅樹
【発明者】
【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内
【氏名】 長曾我部 孝昭
【特許出願人】
【識別番号】 000004547
【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
【氏名又は名称】 日本特殊陶業株式会社
【代表者】 羽賀 征治
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 010353
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【フルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 温度センサ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 先端側が閉塞した軸線方向に延びる筒状の金属チューブと、上記金属チューブの内部に収納され、温度によって電気的特性が変化する感温部とこれに設けられる一対の電極線とを有した感温素子と、上記金属チューブの内部に収納され、上記感温素子の上記電極線と接続される一対の金属芯線をシースパイプ内に絶縁保持してなるシース部材と、を備える温度センサであって、

上記金属チューブは、先端側に位置し、上記シース部材の外径よりも小さい内径を有した小径部と、上記小径部の後端側に位置し、上記小径部の外径よりも大径の大径部とからなり、

上記感温部は上記小径部に収納され、且つ、上記感温部の後端面よりも先端側であって、上記感温部と上記金属チューブとの間には、絶縁部材が介在されている

温度センサ。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の温度センサであって、前記感温部と前記金属チューブの前記小径部との最短距離 L が $0 \leq L \leq 0.3$ mm であり、且つ、上記小径部の外径が 3.5 mm 以下である温度センサ。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 に記載の温度センサであって、前記絶縁部材の後端は、前記シースパイプの先端よりも先端側に位置する温度センサ。

【請求項 4】 請求項 1 又は 2 に記載の温度センサであって、前記絶縁部材の後端と前記シースパイプの先端と間には、断熱部材が設けられる温度センサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、金属酸化物などの半導体からなるサーミスタ焼結体や金属抵抗体等の感温部を有する感温素子を、有底筒状の金属チューブの内部に収納してなる温度センサに関する。更に詳しくは、自動車の排気ガス浄化装置の触媒コンバータ内部や排気管内等といった被測定流体（例えば、排気ガス）が流通する流通路内に感温素子を配置して、被測定流体の温度検出を行う温度センサに関する。

【0002】**【従来の技術】**

従来より、自動車の排気ガス浄化装置の触媒コンバータ内部や排気管内等といった排気ガス流路を流れる排気ガスの温度を、感温素子であるサーミスタ素子によって検出する、いわゆる排気温センサが知られている。この種の温度センサとしては、サーミスタ素子の電極線と接続される金属芯線をシースパイプ内に絶縁保持してなるシース部材を、有底筒状の金属チューブ内に挿入しつつ、サーミスタ素子を金属チューブの先端側内部に配置させた構造の温度センサが知られている（例えば、特許文献1参照）。このような温度センサでは、排気ガスの熱が金属チューブによって受熱され、その後、サーミスタ素子へと熱が伝達されることによって、温度の検出が行われる。

【0003】**【特許文献1】**

特開2000-162051号公報（図1）

【0004】**【発明が解決しようとする課題】**

温度センサにおいては、応答性の更なる向上（高応答化）が要望されている。しかしながら、上記特許文献1に示された温度センサでは、金属チューブとサーミスタ素子との間に空隙が存在しているため、この空隙によって金属チューブからサーミスタ素子への熱の伝達が妨げられてしまう。そのため、このような構造を有した温度センサでは、応答性の更なる向上を図ることが困難であった。

【0005】

そこで、本発明は、上述した問題に鑑み、更なる高応答化を実現することがで

きる温度センサを提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

その解決手段は、先端側が閉塞した軸線方向に延びる筒状の金属チューブと、上記金属チューブの内部に収納され、温度によって電気的特性が変化する感温部とこれに設けられる一対の電極線とを有した感温素子と、上記金属チューブの内部に収納され、上記感温素子の上記電極線と接続される一対の金属芯線をシースパイプ内に絶縁保持してなるシース部材と、を備える温度センサであって、上記金属チューブは、先端側に位置し、上記シース部材の外径よりも小さい内径を有した小径部と、上記小径部の後端側に位置し、上記小径部の外径よりも大径の大径部とからなり、上記感温部は上記小径部に収納され、且つ、上記感温部の後端面よりも先端側であって、上記感温部と上記金属チューブとの間には、絶縁部材が介在されている温度センサである。

【0007】

本発明の温度センサでは、感温部と金属チューブとの間に、絶縁部材が介在されている。このように、金属チューブと感温部とが絶縁部材を介して互いに接している構成とすることで、排気ガス等の熱が金属チューブから感温部まで速やかに伝達される。従って、応答性の良い温度センサとすることができます。

【0008】

また、本発明の温度センサでは、金属チューブが、先端側に位置しシース部材の外径よりも小さい内径を有した小径部と、小径部の後端側に位置し小径部の外径よりも大径の大径部とからなり、感温部は小径部に収納される構成となっている。このように、小径部に感温部を収納することで、感温部と金属チューブとの距離が短くなり、金属チューブから感温部まで熱を速やかに伝達することができるようになる。更に、金属チューブに小径部を設けることで、この部分のサイズ及び容積が小さくなり、応答性を向上させることができる。

【0009】

尚、上記絶縁部材としては、アルミナ粉末を主成分とする骨材とSiを含むガラス成分とからなるセメントや、感温素子の表面又は金属チューブの内表面を被

覆るように形成されたアルミナやシリカ等よりなるガラス層、金属チューブの内表面に形成された金属酸化膜等が挙げられる。

【0010】

更に、上記の温度センサであって、前記感温部と前記金属チューブの前記小径部との最短距離Lが $0 \leq L \leq 0.3$ mmであり、且つ、上記小径部の外径が3.5 mm以下であると良い。

【0011】

応答性を向上させるためには、感温部と金属チューブの小径部との距離を極力近づけると共に、小径部のサイズ及び容積を小さくすれば良い。そこで、本発明の温度センサでは、感温部と金属チューブの小径部との最短距離Lを $0 \leq L \leq 0.3$ mmとし、且つ、小径部の外径を3.5 mm以下とすることで、更に応答性の良い温度センサとすることができます。

【0012】

更に、上記の何れかに記載の温度センサであって、前記絶縁部材の後端は、前記シースパイプの先端よりも先端側に位置すると良い。

【0013】

本発明の温度センサでは、絶縁部材の後端はシースパイプの先端よりも先端側に位置しており、絶縁部材とシースパイプとの間には空隙が形成されている。そのため、排気ガス等の熱が、金属チューブから絶縁部材及びシースパイプを介して、温度センサの基端側へと伝達されること（熱引き）が低減される。従って、更に応答性の良い温度センサとすることができます。

【0014】

更に、上記の何れかに記載の温度センサであって、前記絶縁部材の後端と前記シースパイプの先端と間には、断熱部材が設けられると良い。

【0015】

本発明の温度センサでは、絶縁部材の後端とシースパイプの先端との間に断熱部材が設けられている。そのため、排気ガス等の熱が、金属チューブから絶縁部材及びシースパイプを介して、温度センサの基端側へと伝達されること（熱引き）が低減される。従って、更に応答性の良い温度センサとすることができます。

【0016】

断熱部材は、金属チューブと感温素子の電極線及びシース部材の金属芯線との間、更に、電極線間及び金属芯線間に配置することが好ましい。このようにすることで、金属チューブと電極線及び金属芯線との短絡、及び、電極線間、金属芯線間の短絡を防止することができる。

【0017】

尚、上記断熱部材としては、シリカ及びアルミナを構成材料に含む耐熱纖維（セラミックファイバ）で構成されたもの等を挙げることができる。特に、密度が60～400kg/m³の纖維集合体（バルケファイバ）であり、1000℃において絶縁性かつ柔軟性を有するものが好ましい。

【0018】**【発明の実施の形態】****（実施形態1）**

本発明の実施の形態である温度センサ1について、図面を参照しつつ説明する。図1は、本実施形態の温度センサ1の構造を示す部分破断面図である。また、図2は、図1に示した温度センサ1の要部であるサーミスタ素子2近傍の拡大図である。この温度センサ1は、サーミスタ素子2を感温素子として用いたものであり、同温度センサ1を自動車の排気管に装着することにより、サーミスタ素子2を排気ガスが流れる排気管内に配置させて、排気ガスの温度検出に使用するものである。

【0019】

金属チューブ3は、先端側（図1における下側）が閉塞した有底筒状に形成されており、この先端側の内部にサーミスタ素子2を収納している。この金属チューブ3は、先端側が閉塞する一方で後端側が開口する有底筒状の第1筒状部31と、両端が開口する筒状の第2筒状部32とが、軸線方向に隣接配置される形態で構成されている。より具体的には、第2筒状部32の先端部の外周面を取り囲むように第1筒状部31が配置され、周方向にわたって形成される加締め部39によって加締め固定されると共に、その加締め部39に全周レーザー溶接されることによって一体化されている。なお、この第1筒状部31、第2筒状部32は

、略同等の肉厚を有しており、後述するようにステンレス合金から形成されている。

【0020】

第1筒状部31は、サーミスタ素子2の感温部であるサーミスタ焼結体21を内部に収納している。なお、第1筒状部31のうちで第2筒状部32の先端部の外側面との間で重なり部37を生ずる部位（後端部36）よりも先端側には、第2筒状部32の外径よりも内径が小さく形成された中径部34と、後述するシースパイプ9の外径よりも内径が小さく且つ中径部34の外径よりも外径が小さく形成された小径部33とが基端側から順に形成されている。ここで、後端部36及び中径部34が特許請求の範囲における大径部にあたる。（*請求項では小径部の外径よりも大径の部分を大径部としています。従いまして、後端部36及び中径部34は大径部となります。）また、第1筒状部31には、小径部33と中径部34及び中径部34と後端部36とを繋ぐ段部35、38が形成されており、この段部38の内面に第2筒状部32の先端を当接させることで、第2筒状部32に対する第1筒状部31の軸線方向における位置決めを行っている。

【0021】

第1筒状部31の小径部33の内部には、感温部であるサーミスタ焼結体21の全体が収納される。そして、この小径部33の内部には、絶縁性部材であるセメント10が充填されている。より具体的には、サーミスタ焼結体21の後端面よりも先端側であって、サーミスタ焼結体21の外表面と第1筒状部31（詳細には小径部33）の内表面との間にセメント10が介在するように、小径部33の内部にセメント10が充填されている。そして、本実施形態では、セメント10が、自身の後端面とサーミスタ焼結体21の後端面とが略面一となるように充填されている。そのため、セメント10の後端面と後述するシースパイプ9の先端面との間には、空隙（空気層）101が存在している。更に、サーミスタ焼結体21と小径部33の内表面との最短距離Lが $0 \leq L \leq 0.3\text{ mm}$ 以下であり、且つ小径部33の外径が 3.5 mm 以下（本実施形態では最短距離Lが 0.01 mm 、小径部の外径が 2.3 mm ）となるように、温度センサ1は構成されている。尚、本実施の形態に使用されるセメント10は、アルミナ粉末を主成分とする。

る骨材と、Siを含むガラス成分とからなる。

【0022】

一方、第2筒状部32は、後端側がステンレス合金製のフランジ4の内側に挿通される形態で、同フランジ4に固定される。この第2筒状部32は、内部に後述するシース部材8の先端側を配置している。なお、第2筒状部32の軸線方向における離間した位置（部位）には、自身の外側からシース部材8（詳細には、後述するシース部材8のシースパイプ9の外周面）に向けて加締めることによって形成された先端側加締め部30aと、後端側加締め部30bとが備えられている。この先端側加締め部30aと後端側加締め部30bによって、第2筒状部32とシース部材8とは固定（加締め固定）されている。なお、シース部材8は第2筒状部32に対して両加締め部30a、30bにより固定されるものであるが、両加締め部30a、30bを除く第2筒状部32の内周面とシース部材8のシースパイプ9の外周面との間には、金属チューブ3の後端側から先端側に向かって空気を導く通気経路を形成するための隙間が形成されている。

【0023】

図1に戻り、フランジ4は、軸線方向に延びる鞘部42と、この鞘部42の先端側に位置し、径方向外側に向かって突出する突出部41とを有している。突出部41は、先端側に図示しない排気管の取付部のテーパ部に対応したテーパ形状を有する座面45を有する環状に形成されており、座面45が上記取付部のテーパ部に密着することで、排気ガスが排気管外部へ漏出するのを防止するようになっている。また、鞘部42は環状に形成される一方、先端側に位置する先端側段部44と先端側段部44よりも小さい外径を有する後端側段部43とを備える二段形状をなしている。

【0024】

第2筒状部32は、自身の先端側からフランジ4の後端側より挿入され、鞘部42の内側に圧入固定されている。そして、第2筒状部32の外周面と鞘部42の後端側段部43の内周面との重なり合う部分が、周方向にわたってレーザー溶接されている。

【0025】

フランジ4の周囲には、六角ナット部5 1及びネジ部5 2を有するナット5が回動自在に嵌挿されている。温度センサ1は、排気管の取付部にフランジ4の突出部4 1の座面4 5を当接させ、ナット5により固定される。また、フランジ4の内で鞘部4 2の先端側段部4 4の径方向外側には、筒状の継手6が気密状態で接合されている。具体的には、鞘部4 2の先端側段部4 4の外周面に継手6の内周面が重なり合うように、同継手6が鞘部4 2の先端側段部4 4に圧入され、継手6と先端側段部4 4とが周方向にわたってレーザー溶接されている。

【0026】

金属チューブ3における第2筒状部3 2、フランジ4及び継手6の内部には、一対の金属芯線7をシースパイプ9内に絶縁保持してなるシース部材8が配置される。シース部材8は、第2筒状部3 2に対し、上述したように先端側加締め部3 0 a、後端側加締め部3 0 bにより加締め固定されている。このシース部材8の先端側から突出する金属芯線7は、サーミスタ素子2を構成する一対のP t / R h合金製の電極線2 2に互いに抵抗溶接されことで接続されている。なお、一対の電極線2 2は、自身の先端部が軸断面六角形状をなすサーミスタ焼結体2 1の内部に埋設されており、サーミスタ焼結体2 1と同時に焼成されて形成されている。また、シース部材8は、SUS310Sからなるシースパイプ9と、SUS310Sからなる導電性の一対の金属芯線7と、シースパイプ9と各金属芯線7の間に充填される絶縁粉末とから形成され、金属芯線7が絶縁状態でシースパイプ9に保持されている。

【0027】

継手6の内部にてシース部材8の後端側へ突き出す金属芯線7は、加締め端子1 1を介して一対の外部回路（例えば車両のECU等）接続用のリード線1 2に接続されている。ここで、リード線1 2は、中央に配置されたステンレス線と、この周囲を取り囲むニッケルメッキ軟銅線とを、四フッ化エチレン樹脂からなる絶縁性の被覆部材にて被覆したものである。一対の金属芯線7及び一対の加締め端子1 1は、絶縁チューブ1 5により互いに絶縁される。リード線1 2は、継手6の後端側開口に備えられる耐熱ゴム製の補助リング1 3に挿通される。補助リング1 3は、継手6の上から丸加締め或いは多角加締めされることにより、両者

13、6が気密性を保ちながら互いに固定される。そして、排気ガスの温度変化に応じたサーミスタ焼結体21からの電気的出力は、電極線22、シース部材8の金属芯線7、リード線12を介して図示しない外部回路に取り出され、排気ガスの温度検出に用いられる。

【0028】

なお、この排気ガスの温度を検出する温度センサ1は、1000℃にも達する高温環境下で使用されるため、各々の構成部材は十分な耐熱性を有している必要がある。そのため、金属チューブ3を構成する第1筒状部31及び第2筒状部32、フランジ4、金属芯線7は、Feを主成分とし、C、Si、Mn、P、S、Ni及びCrを含有する耐熱合金であるSUS310Sにより形成されている。また、継手6は、SUS304に形成されている。

【0029】

この温度センサ1は、以下のようにして製造される。まず、SUS310S製の鋼板に深絞り加工を行って、肉厚0.3mm、内径2.7mm、外径3.3mm、全長（軸線方向における寸法）54mmをなし、両端が開口した第2筒状部32と、肉厚0.3mm、全長（軸線方向における寸法）13mmをなす有底筒状の第1筒状部31とを形成する。なお、第1筒状部31については、内径1.7mm、外径2.3mmの小径部33と、内径2.4mm、外径3.0mmの中径部34と、内径3.4mm、外径4.0mmの後端部36と、小径部33と中径部34及び中径部34と後端部36とを繋ぐテーパ形状を有する段部35、38とが形成されるように加工を施した。また、別途SUS310Sの金属体に対して冷間鍛造又は／及び切削加工を施して、第2筒状部32を圧入固定するための内孔と、先端側段部44と後端側段部43とを有する二段形状をなす鞘部42と、この鞘部42の先端側に位置し、径方向外側に向かって突出する突出部41とを有するフランジ4を形成する。

【0030】

そして、第1工程として、サーミスタ素子2の電極線22とシース部材8の金属芯線7とを所定寸法だけ重なるように重ね合わせ、互いを抵抗溶接することによって、シース部材8にサーミスタ素子2が接続された感温素子組立体を作製す

る。

【0031】

なお、シース部材8を構成するシースパイプ9の先端側の所定領域には、後工程において、第1筒状部31と第2筒状部32とを加締め固定した際に形成される加締め部39が自身の外周面に接触しないように、径方向内側に向かって窪む凹部81を形成している。また、このシースパイプ9は、上記凹部81を除く部分の肉厚が0.3mm、外径が2.5mmとなるように形成されている。ついで、第2筒状部32をフランジ4の内孔に圧入固定し、第2筒状部32の外周面と鞘部42の後端側段部43の内周面との重なり合う部分を、周方向にわたってレーザー溶接する。

【0032】

そして、第2工程として、フランジ4にレーザー溶接された第2筒状部32内に感温素子組立体を挿入する。このとき、感温素子組立体のサーミスタ素子2が配置される側から、第2筒状部32の後端側の開口への挿入を開始する。そして、第2筒状部32の先端側からサーミスタ素子2のサーミスタ焼結体21を所定寸法だけ突き出させ、サーミスタ焼結体21が所定寸法突き出た時点で、感温素子組立体の第2筒状部32への挿入を終了する。その後、第2筒状部32の先端側から突き出した状態にある電極線22と金属芯線7との接続部に異常がないかどうか、更には電極線22同士、金属芯線7同士が接触していないかを確認する。この確認作業にて感温素子組立体に異常無しと判断されると、続いて第2筒状部32と感温素子組立体とを固定する作業を行う。

【0033】

第2筒状部32と感温素子組立体との固定については、以下の手順により行う。まず、第2筒状部32のうちで、フランジ4よりも先端側に突き出た部位であって、且つフランジ4の先端に近接した部位を、シース部材8のシースパイプ9の外周面に向けて加締める。この加締め工程は、加締め型を用いて、第2筒状部32の外側から周方向において対向する2点を加締めるようにして行う。これにより、2点の後端側加締め部30bを形成する。

【0034】

ついで、後端側加締め部30bよりも軸線方向先端側に離間した部位であって且つ凹部81よりも後端側の部位を、シース部材8のシースパイプ9の外周面に向かって加締める。この加締め工程についても、上記と同様の加締め型を用い、第2筒状部32の外側から周方向において対向する2点を加締めるようにした。これにより、2点の先端側加締め部30aを形成し、上記後端側加締め部30bと共にシース部材8（感温素子組立体）と第2筒状部32とを加締め固定する。このようにして、第2筒状部32の先端側からサーミスタ焼結体21を所定寸法だけ突き出させた形態で、感温素子組立体と第2筒状部32とを一体的に組み付ける。

【0035】

なお、本実施形態では、先端側加締め部30aおよび後端側加締め部30bが、軸線方向に沿った軸線長さが加締め幅よりも長い寸法を有するように形成されている。具体的に、両加締め部30a、30bのそれぞれは、軸線長さを4.0mm、加締め幅を0.4mmとなるように形成した。

【0036】

ついで、感温素子組立体を組み付けた第2筒状部32に対して、第1筒状部31を組み付けてサーミスタ素子2を有底筒状の金属チューブ3の内部に収納させる第3工程を行う。まず、第2筒状部32の先端側から所定寸法だけ突き出たサーミスタ焼結体21の周囲（但し、サーミスタ焼結体21の後端面は除く）を覆うように、セメント10となる絶縁性ペーストを塗布する。ついで、第2筒状部32の先端側から第1筒状部31を遊嵌状に且つ同軸状に挿入し、第1筒状部31の後端部36が第2筒状部32の先端部の外側面を取り囲むように、第2筒状部32に対して第1筒状部31を隣接配置させる。このとき、第2筒状部32の先端部に遊嵌状態で所定寸法の重なり部37を生ずるように、且つサーミスタ素子2のサーミスタ焼結体21が絶縁性ペーストと共に第1筒状部31の小径部33に収納されるように、第1筒状部31を第2筒状部32に対して配置させる。

【0037】

ここで、本実施の形態では、第1筒状部31を第2筒状部32に挿入するにあたって、第1筒状部31の中径部34の後端側に連結する段部38の内面に第2

筒状部32の先端が当接するまで挿入を行うことで、第2筒状部32に対する第1筒状部31の軸線方向における位置決めを行っている。つまり、本実施の形態では、第1筒状部31を第2筒状部32に遊嵌状且つ同軸状に挿入していき、第2筒状部32の先端が第1筒状部31の段部38の内面に当接した時点で、所定寸法の重なり部37が生ずるように、第1筒状部31の各寸法を予め調整しているのである。これにより、本実施の形態では、第1筒状部31の各寸法を適宜調整し、第2筒状部32の先端が第1筒状部31の段部38の内面に当接するよう挿入を行うことで、第2筒状部32に対する第1筒状部31の軸線方向における重なり寸法を一義的に決めることができる。その結果、サーミスタ焼結体21を第1筒状部31の狙い位置に確実に配置させることが可能となる。

【0038】

ついで、第1筒状部31の後端部36と第2筒状部32の先端部の重なり部37であって、シース部材8のシースパイプ9に形成した凹部81を取り囲む部位において、外側に位置する第1筒状部31を内側に位置する第2筒状部32に向けて周方向に加締め、加締め部39を形成する。なお、この加締めは、八方丸加締めにて行った。このようにして形成される加締め部39は、後述する全周レーザー溶接によるレーザー溶接部形成部位にあたるが、この加締め部39を形成することで、第1筒状部31と第2筒状部32との間の隙間量を減少させることができ、溶接強度に優れる全周レーザー溶接を行うことができる。

【0039】

そして、この重なり部37に形成された加締め部39に対して、レーザー光LBを照射して全周レーザー溶接を行い、第1筒状部31と第2筒状部32とに跨るレーザー溶接部を形成して、両筒状部31、32を一体化する。その後、両筒状部31、32を一体化した組立体を加熱処理することで、絶縁性ペーストを固化させてセメント10を得る。

【0040】

ついで、公知の手法により、加締め端子11を用いてシース部材8の金属芯線7の後端部とリード線12とを電気的に接続する。その後、筒状の継手6を、鞘部42の先端側段部44の径方向外側に圧入して、継手6と先端側段部44を周

方向にわたってレーザー溶接する。これにより、フランジ4に対して継手6を気密状態に固定する。そして、補助リング13やナット5等を適宜組み付ける。このようにして、温度センサ1の製造を完了する。

【0041】

このような本実施形態の温度センサ1においては、サーミスタ焼結体21の後端面よりも先端側であって、サーミスタ焼結体21の外表面と金属チューブ3の第1筒状部31（詳細には小径部33）の内表面との間にセメント10が介在するように、小径部33の内部にセメント10が充填されている。このように、セメント10が介在することで、金属チューブ3（第1筒状部31）の受熱を、セメント10を介してサーミスタ素子2に効率良く伝熱することができ、温度検出の高応答化を図ることができる。更には、振動等によるサーミスタ素子2の揺動が防止される。また、サーミスタ焼結体21が金属チューブ3の小径部33の内部に収納されているので、この部分のサイズ及び容積が小さくなり、応答性を向上させることができる。更には、サーミスタ焼結体21と金属チューブ内表面（詳細には小径部33内表面）との距離を短くすることができ、更に応答性を向上させることができる。

【0042】

更に、本実施形態の温度センサ1では、セメント10の後端面とシースパイプ9の先端面との間には、空隙101が存在している。従って、金属チューブ3からセメント10及びシースパイプ9を介して、温度センサ1の基端側へと熱が伝達される熱引きを低減することができる。また、サーミスタ焼結体21と小径部33の内表面との最短距離Lが $0 \leq L \leq 0.3\text{ mm}$ となり、且つ小径部33の外径が 3.5 mm 以下となるように、温度センサ1を構成している。このように、最短距離L及び小径部33の外径を設定することで、更に応答性の良い温度センサとすることができます。

【0043】

（実施形態2）

次に、本発明の第2の実施形態について、図3を用いて説明する。上記の実施形態1では、セメント10の後端面とシースパイプ9の先端面との間に、空隙1

01が形成されていた。これに対し、本実施形態2の温度センサ100では、セメントの後端面とシースパイプの先端面との間に、断熱部材を設けた点で異なり、他の点は同様である。従って、異なる部分のみを説明し、同様な部分の説明は省略する。

【0044】

図3は、温度センサ100の要部であるサーミスタ素子2近傍の拡大図である。この温度センサ100では、セメント10とシースパイプ9との間に、アルミニナ系セラミックファイバからなる断熱部材102が設けられている。この断熱部材102は、金属チューブ3と電極線22及び金属芯線7との間、更に、電極線22間及び金属芯線7間に介在するように配置されている。従って、金属チューブ3からセメント10及びシースパイプ9を介して、温度センサ1の基端側へと熱が伝達される熱引きを低減することができる。また、金属チューブ3と電極線22及び金属芯線7との短絡、及び、電極線22間及び金属芯線7間の短絡を防止することができる。

【0045】

ここで、上記実施形態1及び実施形態2の温度センサの効果を確認する試験を行った。

【0046】

まず、サーミスタ焼結体2と金属チューブ3の小径部33内表面との最短距離L及び小径部33の外径と応答時間との関係を調査した。実施形態1と同様の構成であって、サーミスタ焼結体21と金属チューブ3（の小径部33）内表面との最短距離L及び小径部33の外径が異なる5種類の温度センサ（試料No. 1～試料No. 5）を作製した。これら各温度センサを、600℃、20m/sの排気ガスが存在する排気管内に、サーミスタ焼結体21が位置するように投入した。そして、温度センサからの信号が室温から600℃の63%（つまり、378℃）になるまでの時間（応答時間）を測定した。その結果を表1に示す。

【0047】

試料No.	最短距離L(mm)	小径部の外径(mm)	応答時間(秒)
1	0.01	2.3	5.4
2	0.21	2.7	5.9
3	0.3	3.5	6.5
4	0.51	3.3	8.7
5	0.21	3.7	10.8

【0048】

最短距離L及び小径部33の外径が小さくなるにつれて応答時間は速くなり、最短距離Lが $0 \leq L \leq 0.3$ mmであり、且つ、小径部33の外径が3.5 mm以下である場合（試料No. 1～試料No. 3）、応答時間が6.5秒以下となった。特に、小径部33の外径が3.0 mm以下（試料No. 1、試料No. 2）であると、応答時間が6秒以下となった。この結果より、最短距離Lが $0 \leq L \leq 0.3$ mmであり、且つ、小径部の外径が3.5 mm以下とすれば、更なる高応答化を実現できる温度センサとすることができます。

【0049】

次に、サーミスタ焼結体21とシースパイプ9との間に、空隙（空気層）101或いはセラミックファイバからなる断熱部材102を設けたことの効果について調査を行った。実施形態1にかかる温度センサ（空隙（空気層）101を設けた温度センサ、試料No. 6）と、実施形態2にかかる温度センサ（セラミックファイバからなる断熱部材102を設けた温度センサ、試料No. 7）と、実施形態1と同様の構成であって、サーミスタ焼結体21とシースパイプ9との間にセメント10が充填され、サーミスタ焼結体21とシースパイプ9とがセメント10を介して互いに接している温度センサ（試料No. 8）の3種類の温度センサを作製した。これら各温度センサを、上記試験と同様に試験を行い、応答時間を測定した。その結果、サーミスタ焼結体21とシースパイプ9とがセメント10により接続されている試料No. 8の温度センサでは応答時間が6.2秒であった。これに対し、実施形態1及び実施形態2にかかる温度センサ（No. 6、No. 7）では、応答時間は共に5.4秒であり、応答時間が短くなった。この結果より、サーミスタ焼結体21とシースパイプ9との間に、空隙（空気層）1

01或いは断熱部材102を設けることで、高応答化を実現できる温度センサとすることができる。

【0050】

以上において、本発明を実施の形態に即して説明したが、本発明は上述した具体的な実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更して適用できることはいうまでもない。例えば、感温部をなすサーミスタ焼結体21の形状は、軸断面において六角形状に限定されず、円形状や橢円形状であっても良い。また、温度センサ1、100は、排気温センサのみならず、被測定流体として水や油等の液体が流れる流通路に取り付けられる温度センサにも適用可能である。更に、上記特許文献1に開示された温度センサのように、シース部材の先端側外表面にサーミスタ素子を収納する有底筒状の金属キャップを溶接した構造の温度センサにも適用可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施形態における温度センサ1の全体構造を示す部分破断面図である。

【図2】

図1に示す温度センサにおいて、要部であるサーミスタ素子2近傍の拡大図である。

【図3】

第2の実施形態における温度センサ100において、要部であるサーミスタ素子2近傍の拡大図である。

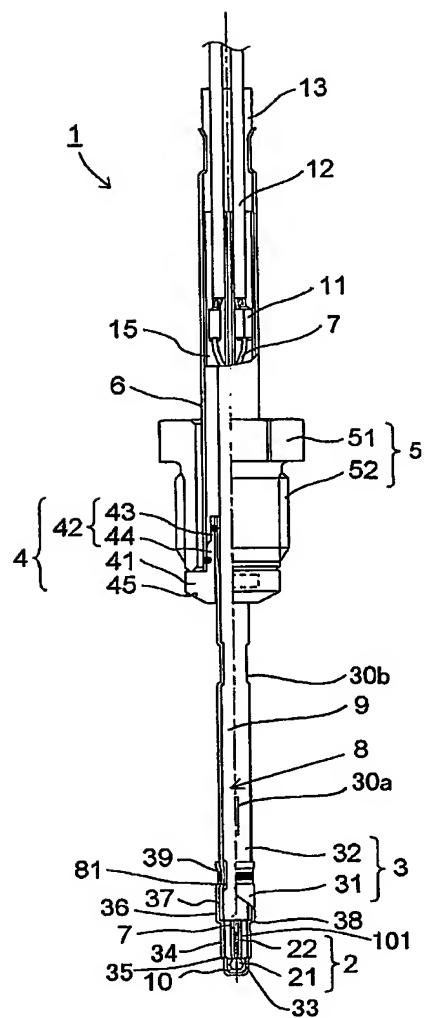
【符号の説明】

1、100…温度センサ、2…サーミスタ素子、21…サーミスタ焼結体、22…電極線、3…金属チューブ、30a…先端側加締め部、30b…後端側加締め部、31…第1筒状部、32…第2筒状部、33…小径部、34…中径部、35…段部、36…後端部、38…段部、37…重なり部、39…加締め部、4…フランジ、6…継手、7…金属芯線、8…シース部材、9…シースパイプ、10…セメント、12…リード線、101…空隙（空気

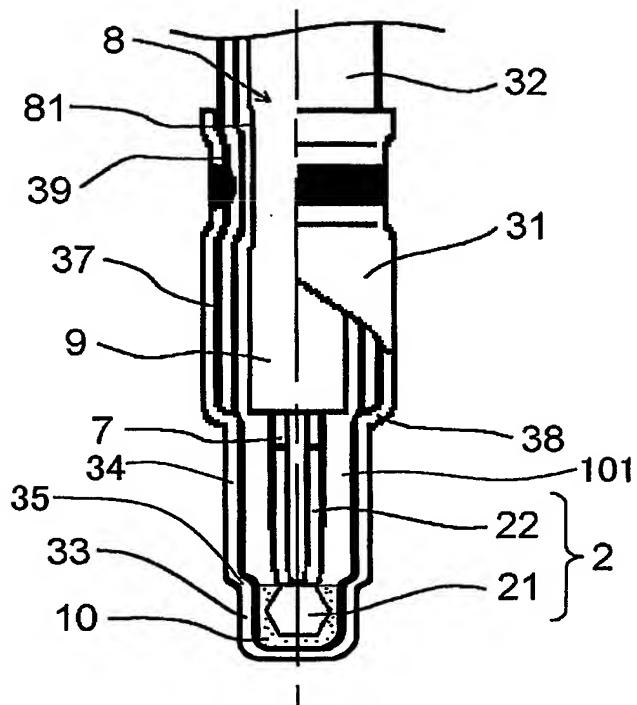
層)、102…断熱部材

【書類名】 図面

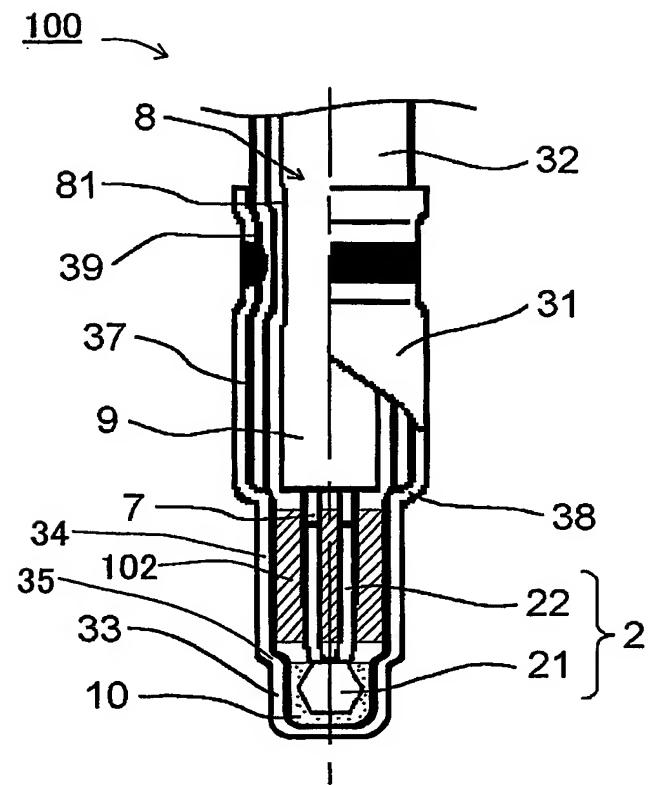
【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 金属チューブ内にサーミスタ素子を収納した温度センサにおいて、更なる応答性の向上を図る。

【構成】 先端側が閉塞した筒状の金属チューブ3の内部に、サーミスタ素子2が接続されたシース部材8を収納した温度センサ1であって、金属チューブ3は、先端側に位置し、シース部材8の外径よりも小さい内径を有した小径部33と、小径部33の後端側に位置し、小径部33の外径よりも大径の大径部36とかなり、サーミスタ焼結体21は小径部33に収納され、且つ、サーミスタ焼結体21の後端面よりも先端側であって、サーミスタ焼結体21と金属チューブ3との間には、セメント10が介在されている。

【選択図】 図1

特願 2003-089560

出願人履歴情報

識別番号

[000004547]

1. 変更年月日 1990年 8月 8日

[変更理由] 新規登録

住所 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
氏名 日本特殊陶業株式会社